

2018年9月25日
凸版印刷株式会社

凸版印刷、2018 東京国際包装展に出展

10月2日(火)～5日(金)、IoT や AI の活用や持続可能な社会に貢献するパッケージなど
凸版印刷が描くパッケージの未来像を最新の開発商品とともに紹介

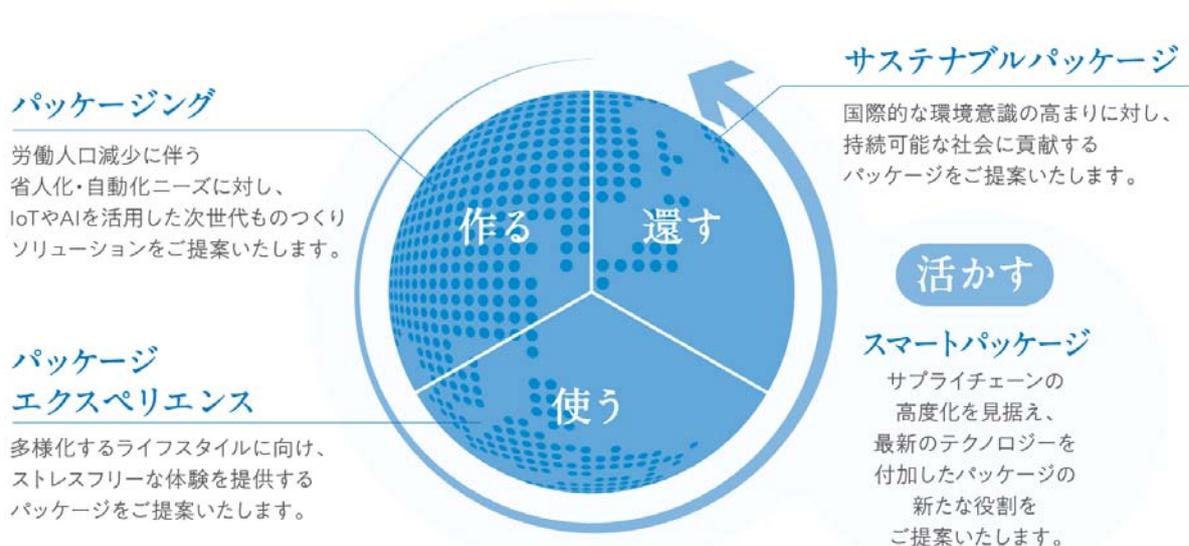
凸版印刷株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:金子眞吾、以下 凸版印刷)は、2018年10月2日(火)～5日(金)に東京ビッグサイトで開催される「TOKYO PACK 2018 - 2018 東京国際包装展 -」(以下 2018 東京国際包装展)に出展します。今回、凸版印刷ブース(東2ホール・小間番号2-42)では、凸版印刷の描くパッケージの未来像と、それに向けた最新の開発商品を、商品サイクルのシーン毎に紹介します。

国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」に象徴される企業規模、国家規模で加速する環境への取り組み、IoT に代表されるテクノロジーの進化など、わたしたちを取り巻く社会環境は、日々変化しつづけています。そうした中で凸版印刷は、お客さまと新しい価値を共創すべく、新たな製品・サービスの開発と提供に全力で取り組んでいます。

今回「考えよう 地球をまもるパッケージ」がテーマの 2018 東京国際包装展において、凸版印刷では、持続可能な社会の実現に向けたサステナブルパッケージや ICT 対応のスマートパッケージなど、最新の開発商品とともに凸版印刷が描くパッケージの未来像を紹介します。

■ 展示テーマ

今回の 2018 東京国際包装展で凸版印刷は、「作る、使う、還す」のサイクルを軸に、大きく4つのテーマで展示を行います。展示テーマはそれぞれ、労働人口減少に向けて IoT や AI を活用した「パッケージングソリューション」、多様化するライフスタイルに対応する「パッケージエクスペリエンス」、最新のテクノロジーを付加して新たな役割を果たす「スマートパッケージ」、そして持続可能な社会に貢献する「サステナブルパッケージ」です。



■ セミナー

期間中、凸版印刷ブース内で、食品・ヘルスケア業界など幅広い業界向けに、凸版印刷の新たな技術や旬の取り組みを紹介するセミナーを開催します。

<主なセミナーテーマ>

サステナブルパッケージ、スマートパッケージ、製造現場向けソリューション、バリアソリューションなど

■ 展示会概要

- ・名称:TOKYO PACK 2018 — 2018 東京国際包装展 —
Tokyo International Packaging Exhibition 2018
- ・会期:2018年10月2日(火)～5日(金) 10:00～17:00
- ・場所:東京ビッグサイト
- ・主催:公益社団法人日本包装技術協会(Japan Packaging Institute)
- ・公式サイト URL:<http://www.tokyo-pack.jp>

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上